

上海灏谷集成电路技术有限公司

Shanghai Magic Valley IC Technology Co. Ltd.

报价单

Quotation Number: Q170124V2.0 日期: 2017/10/23 Customer Code: GE053-B Project Code: HGM467A

TO: FROM: 上海灏谷集成电路技术有限公司 上海酷芯微电子有限公司

联系人: 钟琪

传真:

上海市杨浦区淞沪路308号创智天地9号楼6楼 地址:

13916320571 电话:

电子邮件: qi.zhong@artosyn.cn

联系人: 周宏

地址: 上海市复兴中路1号申能国际大厦1207A

电话: 021-60495752 传真: 021-63150301

电子邮件:<u>criszhou@hgwdz.com</u>

报价: 6.6807

序号	内容	金额(USD)	金额(RMB)
1	工艺: 28nm CMOS LOGIC High Performance Compact Mobile Computing ELK CU 1P8M 38L HKMG 0.9/1.8V - 12 inch Wafer Option - 28nm ESD - 12inch*1 Layer(s) Wafer Option - 28nm ETCH - 12inch*1 Layer(s) Wafer Option - 28nm Implant - 12 inch * 6 Layer(s) Wafer Option - 28nm Polyimide - 12 inch * 1 Layer(s)		
1.1	Mask Count(Process Layers): 47 Layers	\$1,521,000.00	¥10,161,344.70
1.2	Pilot/Engineering Wafer Lot Price (6pcs/lot)	\$35,064.00	¥234,252.06
1.3	Bumping NRE Fee	\$8,000.00	¥53,445.60
1.4	Bumping Lead-free Fee (Unit Fee: \$230/pcs, Total 6pcs)	\$1,380.00	¥9,219.37
1.5	服务费	\$23,481.66	¥ 156,873.93
1.6	进口付汇报关物流费		¥5,000.00
1.7	增值税(17%)		¥ 1,805,423.06
	Subtotal	\$1,589,725.66	¥ 12,425,558.72
Α	Total	\$1,589,725.66	¥12,425,558.72

Production wafer unit Price: USD4870.00

- 1. 本报价单仅为量产所需的47层Mask、6片工程批 WAFER和Bumping的报价,不包含 Split、封装、减薄、运杂费等。
- 2. 报价单单所涉及的全部费用需在生产前100%预付,汇率按外管局中间价上浮0.06计算,实际根据购汇当日汇率更新结算。
- 3. 交付时间: TBA
- 4. 报价单保密条款/申明:本报价单为机密信息。根据中华人民共和国法律的规定,客户不得将本报价单所载仸何信息披露给第三方。
- 5. 报价有效期:7天
- 6. 本合同一式两仹, 自签订之日起生效, 传真及扫描件有效。
- 7. 报价单中包含17%税金,发票将在货物全部进口并交付后的两周内快递寄至贵司。

银行信息:

户名:上海灏谷集成电路技术有限公司

账号:98250154740008548

开户银行:上海浦东发展银行 南市支行 纳税人识别号:913101155852209133

地址、电话:浦东新区川沙路1098号8幢 021-60495753

供方(盖章):	上海灏谷集成电路技术有限公司	需方(盖章):上海酷芯微电子有限公司
委托代表:	周宏	委托代表:
联系电话:	021-60495752	联系电话: